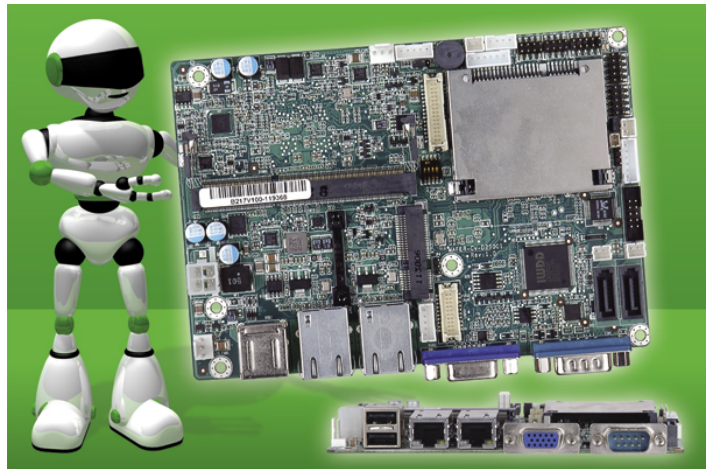


## Pressemitteilung 04.01.2012

### WAFER-CV-D27001

#### Besonderheiten:

- 3.5" CPU Board with Intel® Cedarview dual core processor D2700
- Max. 4GB DDR3 SO-DIMM
- 12V only single voltage design for AT/ATX
- Open frame heatsink thermal design for fanless solution
- Flexible VGA, 18/24bit LVDS with dual display support
- Complete I/O with 6 x USB, 2 x SATA II, 1 x mSATA, 4 x COM and Audio



### Ultra Low Power Cedarview Embedded Board

Das 3.5" CPU Board WAFER-CV-D27001 von der ICP Deutschland GmbH basiert auf der leistungsstarken, aber dennoch stromsparenden Intel® Cedarview Plattform. Dem Intel® NM10 Express Chipsatz steht ein Dual Core™ D2700 Prozessor mit 2.13GHz und bis zu 4GB DDR3 SO-DIMM zur Seite. Der zusätzliche Grafikchip Chronitel CH7511 ermöglicht eine Auflösung von 1920x1200 auf dem VGA und von 2560x1600 auf dem LVDS Ausgang mit Dual Display Support. Das Board wird bereits mit einer kombinierten Kühl- und Montageplatte ausgeliefert, die die Wärme des Prozessors und Chipsatzes von der Unterseite des Boards direkt ableitet. Somit eignet sich das WAFER-CV-D27001 besonders für Systemhersteller von Panel PC, HMI und Digital Signage Lösungen. Auch die Verwendung von nur einer 12V Versorgungsspannung ist für die Integration von Vorteil. Neben den herausgeführten Schnittstellen (VGA, COM, Dual GbE und zwei USB) verfügt das WAFER-CV-D27001 noch über weitere sechs USB, drei COM und zwei SATA II sowie KB/MS, Audio und je vier digital I/O. Für benutzerspezifische Erweiterungen steht ein Fullsize Mini PCIe Card Slot zur Verfügung, der auch mSATA SSD Drives unterstützt.

### ICP. Inventive Computer Products